

## 熱硬化型(一液性)永久穴埋めインキ

# THP-100 Z2

(UL:THP-100Z1)

### 1. 特 長

THP-100 Z2は、短時間硬化が可能で、印刷性と保存安定性に優れた熱硬化型一液性永久穴埋めインキです。

### 2. 一 般 仕 様

色 調	白色
粘 度	350dPa・s (コンプレート型粘度計 5min <sup>-1</sup> /25℃)
標準硬化条件	熱風循環式乾燥炉 150℃ 15分
有効期限	180日(10℃以下暗所保管)

### 3. プ ロ セ ス

標準工程		適正範囲
インキ開缶	インキが室温になった状態で開缶	[10-30分]
インキ攪拌・脱泡	脱泡攪拌機 20分	
基板	パネルめっき後のTH基板	[80~120メッシュ]
前処理	銅表面の酸化被膜除去	
印刷	100メッシュテトロンスクリーン使用 (ドットパターン印刷) ※専用スキージの使用をお薦めいたします。	
硬化	熱風循環式乾燥炉 150℃ 15分	[150℃ 15~30分]
研磨	穴埋め樹脂用研磨#320 バフ使用	#220~#600

## 4.プロセス上の注意

- ・穴埋めプロセスは、パネルめっき後の基板で行ってください。パターン(回路)形成は、前記プロセス後にお願いします。
- ・作業環境はクリーンルームで20~25℃、50~60%RHをお勧めします。
- ・インキの温度を室温に戻してから開缶し、十分に攪拌してから使用して下さい。
- ・版の洗浄はエーテル、エステル系溶剤で洗浄できます。
- ・硬化条件は、乾燥機の種類、基板投入枚数により異なりますので、確認試験を行った上で設定して下さい。特に硬化不足の場合は塗膜特性が低下する傾向があります。

## 5.インキ特性(塗膜特性)

項 目	試 験 条 件	試 験 結 果
密 着 性	社内法 クロスカット試験	100/100
鉛 筆 硬 度	社内法 銅箔表面まで達しない硬度	>6H
はんだ耐熱性	TH 充填後、SR 層を形成。処理後の SR の剥がれを確認。 ロジン系フラックス 260℃20秒×2回 はんだフロート	異常無し
吸 水 率	純水浸漬 (23℃ 24時間浸漬)処理後の吸水率 硬化後の塗膜厚: 100 μ m	0.7%
ガラス転移点	TMA 引張法(X,Y 方向) Tg: α 1 α 2	155℃ 41ppm 110ppm

\* インキ特性値は、FR-4(1.6mmt)/PTH0.25mm を使用し、前記プロセス条件及び各項目に記載した条件にて試験した際のデータです。尚、技術資料の記載内容は、弊社の実験結果に基づくものですが、これを保証するものではありませんので、目的とする特性を確認の上、使用して下さい。

## 6.その他

- ・全ての化学品には未知の有害性があり得るため、取扱には細心の注意が必要です。取扱上の注意に関しては製品安全データシート(SDS)を参照の上、作業を行ってください。
- ・本カタログ記載製品には、RoHS II 指令規制対象10物質(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム 及び特定臭素系難燃剤(PBB及びPBDE)、フタル酸エステル系物質(DEHP, DBP, BBP, DIBP)の工程での使用及び製品への意図的使用による含有はありません。